

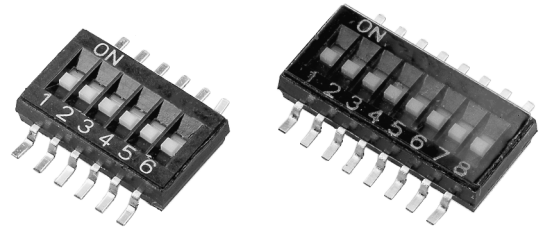
# 5042

## SMT DIP-Schalter - RM 1,27 mm

SMT DIP-Switch - Pitch 1,27 mm

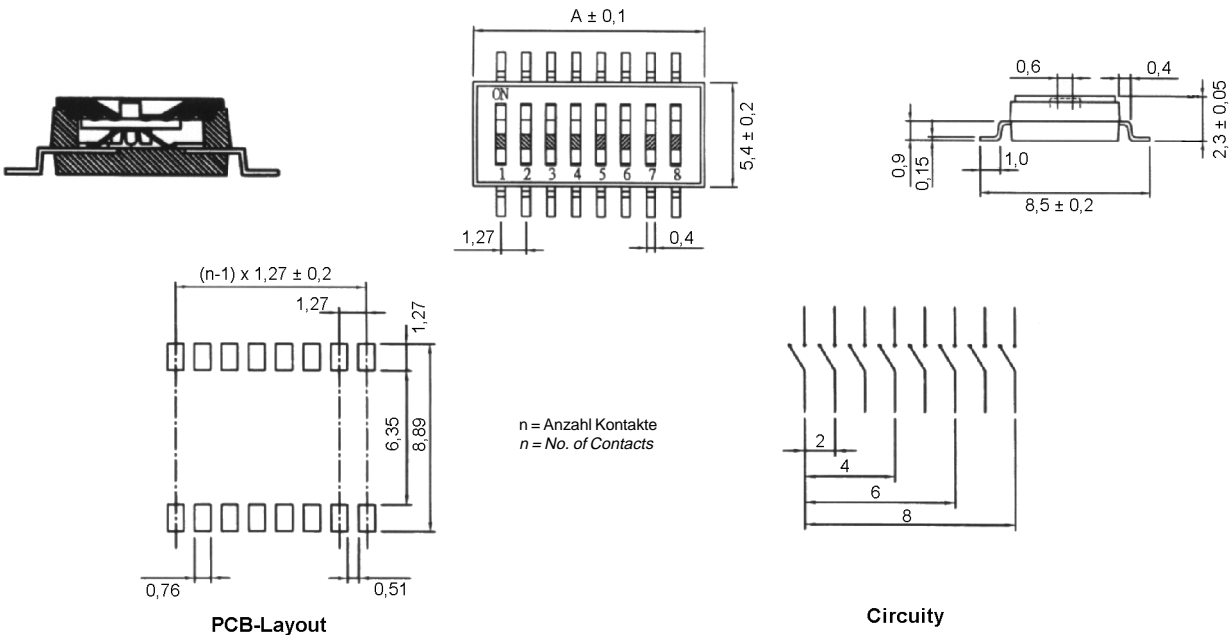
### Technische Daten / Technical Data:

Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0 <i>Thermoplastic, rated UL94V0</i>
Farbe <i>Colour</i>	schwarz <i>black</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze, vergoldet über Nickel <i>Phosphor Bronze, gold plated over nickel</i>
Kontaktbelastbarkeit	50 V <sub>DC</sub> 100 mA in Ruhe 24 V <sub>DC</sub> 24 mA im Schaltzustand 50 V <sub>DC</sub> 100 mA at steady situation 24 V <sub>DC</sub> 24 mA at mate and break
Contact Rating	≤ 100 mOhm im Auslieferungszustand ≤ 100 mOhm at initial
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	> 10 <sup>8</sup> Ohm bei 500 V <sub>DC</sub> > 10 <sup>8</sup> Ohm at 500 V <sub>DC</sub>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	500 V <sub>AC</sub> , 1 min. 500 V <sub>AC</sub> , 1 min.
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	Temperaturbereich -20°C...+85°C Temperature Range -20°C...+85°C
Mechanische Lebensdauer <i>Mechanical Life</i>	min. 2000 Schaltungen/Schalter min. 2000 operations/switch
Elektrische Lebensdauer <i>Electrical Life</i>	min. 2000 Schaltungen/Schalter min. 2000 operations/switch
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T Reflow-Soldering, further informations in chapter T



© W+P PRODUCTS

E



Series	Contacts	Slide	Packing*
5042	08	20	TR
	02 = A: 4,12 04 = A: 6,66 06 = A: 9,20 08 = A: 11,74 10 = A: 14,28	20 = versenkter Hebel, mit Folie versiegelt recessed actuator, top tape sealed	TR

**Lieferformen / Packing Options:**  
TR = Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications.)

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):*

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

*Recommended Reflow-Soldering profile:*



T